Proc. Symp. Ultrason. Electron., Vol. 24, (2003) pp.181-182 12-14 November, 2003

P2-E-32

圧電素子光熱分光法による微結晶シリコン薄膜の 光吸収スペクトル

Piezoelectric photo-thermal study of the optical absorption spectra of microcrystalline silicon

〇王萍、多田真樹、大田将志、境健太郎、福山敦彦、碇哲雄(宮崎大・工) Wang Ping, Masaki Tada, Masasi Ohta, Kentaro Sakai, Atsuhiko Fukuyama and Tetsuo Ikari (Miyazaki Univ.)

1.背景

微結晶シリコン(µc-Si)は現在の主流である アモルファスシリコンや多結晶シリコンに代わ る次世代の太陽電池材料として最も有望視され ている。その理由として低コストで作成可能であ ることや、アモルファスシリコン太陽電池で問題 となっている光劣化現象が観測されないことが あげられる。しかしながらµc-Si を用いた太陽電 池が既存電力と競争しうるためには毎秒約5nm以 上の製膜速度を必要とするが、製膜速度を上げる と変換効率が低下してしまうため、実用化への大 きな障害となっている。μc-Si の光学的特性を評 価するための重要な実験手法として光吸収スペ クトルの測定があるが、膜が薄いため、ほとんど の光が透過してしまい、精度良くスペクトルを測 定することが困難である。そこで我々は半導体中 の電子の非輻射再結合を高感度に測定できる圧 電素子光熱分光(PPT)法^{1,2}を用いてuc-Siの光吸 収スペクトルの測定を試みた。PPT 法は光吸収後 の非輻射再結合過程を測定する絶対測定である ため透明な材料に対しても感度がよく、また散乱 光の影響も除去できる。得られた PPT スペクトル をもとに、製膜速度によるµc-Si の光学的特性の 変化について評価した。

2. 測定方法

ガラス基板上にプラズマ CVD 法で製膜させた、 製膜速度が3倍程度異なる μ c-Si 薄膜(厚さそれ ぞれ 0.5、1.0、1.5 μ m、基板温度 200 \mathbb{C})の6 種類 を試料として用いた。ラマン測定により評価した μ c-Si 薄膜の結晶化率には異なる製膜速度の試料 間で大きな違いはみられなかったが、同薄膜を用 いて作製した太陽電池では、製膜速度増加で変換 効率が約半分に低下することが分かっている。

PPT スペクトル測定装置の概略図を **Fig.1**に 示す。測定は以下の手順で行った。まず試料の μc-Si 薄膜成長面に検出器である圧電素子(PZT) をシリコングリースで接着させ、クライオスタッ ト内に設置した。その後、400~1400nm の波長範 囲で測定光をガラス基板側から試料に照射し、 PPT スペクトルを測定した。μc-Si の吸収係数が 小さく膜厚が薄いことから、得られた PPT スペク トルに対し、検出器への測定光入射による影響の 除去とμc-Si 薄膜内での測定光の膜内干渉の補正 を行って、最終的な PPT スペクトルを得た。



Fig.1 Schematic diagram of PPT spectroscopy

3. 結果・考察

低速製膜試料では測定光のフォトンエネル ギーの増加に従って、約1.2eV 付近から PPT 信号 強度が単調に増加するスペクトルが得られた。一 方、高速製膜試料では、同様に約1.2eV 付近から の PPT 信号強度増加を示すが、約 2.3 eV 以上の領 域では信号強度が減少した。また、測定したフォ トンエネルギー領域に渡って、低速製膜試料の PPT 信号強度が高速製膜試料の PPT 信号強度より も大きいことが分かった。これらの結果は他の膜 厚試料(0.5 および $1.5\mu m$)においても同じであっ た。今回のような、光学的に透明な条件下での PPT 信号強度は材料の光吸収係数 α に比例する ¹⁾こと から、製膜速度増加による PPT 信号強度減少の原 因の一つとして μc -Si 薄膜の α の減少を考えるこ とができる。



Fig.2 The $(h\nu PPT)^{0.5}$ vs $h\nu$ plots of the low and high deposition rate samples.

PPT 信号強度がαに比例するので、μc-Si の 光学遷移が間接バンド間遷移であると想定して (hν PPT)^{0.5} vs hνプロットを行ったのが**Fig. 2** である。プロット解析の結果、以下の二つのこと が分かった。一つは、μc-Si の光学バンドギャッ プ(Eg、図中矢印)が製膜速度増加によって高エ ネルギー側へシフトする事、もう一つは、製膜速 度増加によって低エネルギー側にバンドテイル が顕著に現れることである。前者の、Eg が高エネ ルギー側へシフトした原因として、薄膜内のアモ ルファス成分の増加あるいは水素含有量の増加³ が考えられる。ただし、同一試料のラマン測定か ら製膜速度によるµc-Si 薄膜の結晶化率に大きな 違いが見られなかったことから、水素含有量の増 加がEgシフトの大きな原因と推測される。一方、 バンドテイルの出現は構造乱れによりギャップ 内に局在準位が形成されたものと考えることが 出来る。

今回の PPT スペクトル測定から得られた、製 膜速度によるµc-Si の光学的特性変化はすべて太 陽電池の変換効率低下につながる。つまり、製膜 速度増加によって光学バンドギャップが高エネ ルギー側へ移動し、同時に膜の光吸収係数が減少 することにより、太陽光吸収で発生するキャリア が減少する。また、発生した局在準位がキャリア トラップとして働くために出力電流が低下し、結 果として高速製膜µc-Si 太陽電池における変換効 率が低下したと説明できる。

4. まとめ

PPT 法を用いて、µc-Si の光吸収スペクトル を測定し、製膜速度変化の影響について評価した。 その結果、製膜速度増加による光学バンドギャッ プの高エネルギー側へのシフト、光吸収係数の低 下、ギャップ内局在準位形成に起因するバンドテ イルの出現が明らかとなった。これらはµc-Si 太 陽電池の変換効率の低下につながる。今回の結果 によって、PPT 法が透明基板上に形成された薄膜 評価に有効なことが示された。

参考文献

- T. Ikari, H. Yokoyama, S. Shigetomi, and K. Futagami, Jpn. J. Appl. Phys. 29 (1990) 887.
- S. Tada, S. Sato, A. Ito, A. Fukuyama, and T. Ikari, Jpn. J. Appl. Phys. 41 (2002) 3358.
- D. A. Papaconstantopoulos and E. N. Economou, Phys. Rev. B 24 (1981) 7233.